

金川集团股份有限公司半导体封装新材料（兰州）

生产线建设项目更正公告

招标编号：GZ2301086-JCBDTLZ

甘肃省招标中心有限公司受金川集团股份有限公司的委托，对半导体封装新材料（兰州）生产线建设项目进行国内公开招标，现将相关事宜公示如下：

设备名称：小型数控加工中心A型

原公告内容：

窗体顶端

开标时间及投标文件递交截止时间：2023年2月16日（星期四）上午09时00分。

窗体底端

更正如下：

窗体顶端

开标时间及投标文件递交截止时间：2023年2月24日（星期五）上午09时00分。

窗体底端

联系人：范玉琛

电 话：18809450505

电子邮箱：18809450505@163.com

2023年2月15日